

Mech-Eye DEEP 산업용 3D 카메라

물류 산업의 디팔레타이징 및 팔레타이징 애플리케이션에 적용

초광각 | 고정밀도 | 원거리 작업

고성능 | 경쟁력 있는 가격 | 간단한 플러그 및 플레이 설정



MTBF : $\geq 40,000$ 시간

기술적 파라미터

추천 작업 거리 범위 : 1200-3500 mm

근거리 FOV : 1200 × 1000 mm @ 1.2 m

원거리 FOV : 3500 × 2800 mm @ 3.5 m

덱스 맵 해상도 : 2048 × 1536

RGB 해상도 : 2000 × 1500

단일점의 Z방향 반복 정밀도(σ)^[1] : 1.0 mm @ 3.0 m

VDI/VDE 측정 정밀도^[2] : 3.0 mm @ 3.0 m

일반적인 캡처 시간 : 0.5-0.9 s

이미지 센서 : 하이엔드 머신 비전을 위한 Sony CMOS

기선 길이 : 300 mm

치수 : 366 × 77 × 92 mm

무게 : 2.4 kg

광원 : 레드 레이저(638 nm, Class 2)

작업 온도 범위 : -10-45 °C

통신 인터페이스 : 기가비트 이더넷

입력 : 24V DC, 3.75A

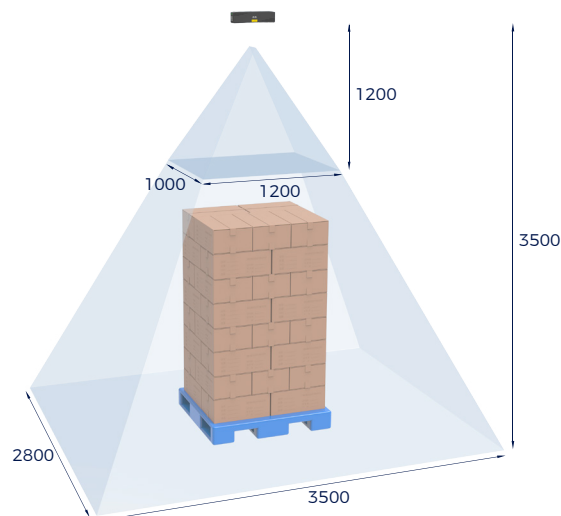
안전 및 전기파 적합성 : CE/FCC/VCCI/KC/ISED/NRTL

보호 등급 : IP65

냉각 방식 : Passive

MTBF : $\geq 40,000$ 시간

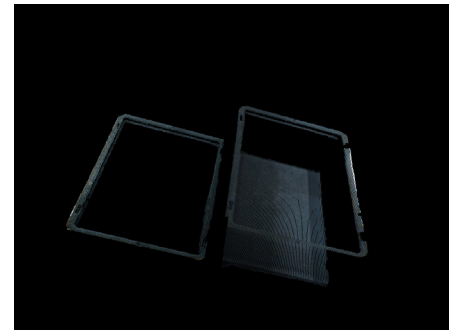
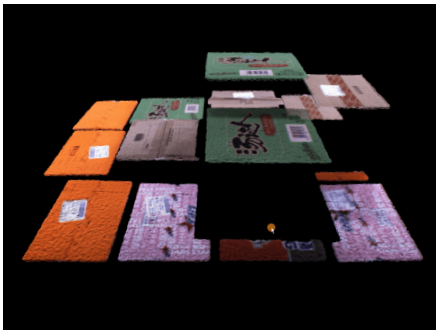
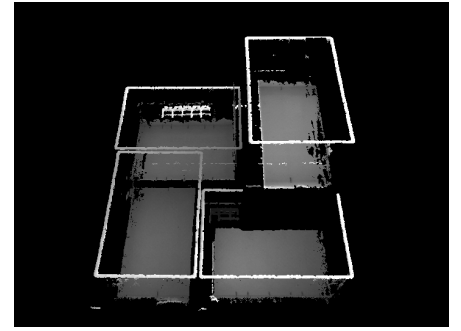
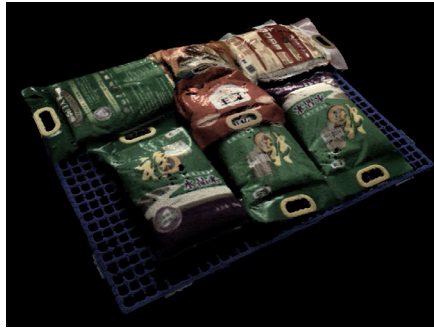
시야(mm)



[1] 단일한 점의 Z 값에 대해 100 번 측정 후의 1 배 표준 편차. 측정 대상은 세라믹 플레이트입니다.

[2] VDI/VDE 2634 Part II 표준을 기준으로 합니다.

3D 포인트 클라우드



촘촘하게 포장된 패턴과 테이프가 있는 박스

촘촘하게 포장된 패턴이 있는 포대

토틈 박스

광각 FOV가 요구되는 물류 애플리케이션에 적용된 디자인

